

# 2022年3月期 第3四半期 決算説明資料

東証JASDAQ 証券コード：6614  
2022年2月10日

## 売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

- 車載半導体検査装置、半導体設計受託の好調が継続し今第3四半期（以下、3Q）は予想を上回る進捗となりました。
  - 売上高は新型コロナウイルス、材料納期遅延の影響を受けましたが、3Q計画比増収。
  - 経常利益は高付加価値製品・コスト削減の取組み等により3Q計画比増益を達成。
  - 2021年8月11日公表の年間予想比の進捗率98.6%を達成しました。
- 受注は好調を維持しており、部品の長納期化の影響を考慮したうえで通期業績見通しを上方修正します。

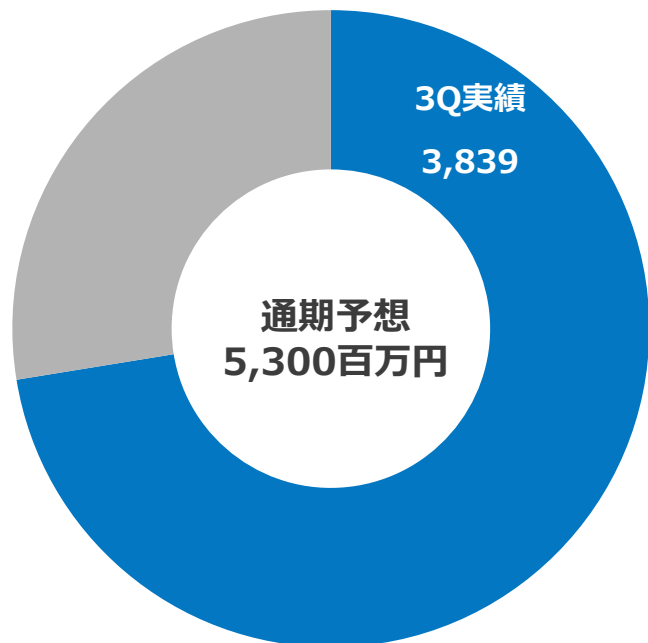
(単位：百万円)

	2022年3月期 業績予想 (8/11修正)	2022年3月期 1Q,2Q実績累計 (4~9月)	2022年3月期 3Q実績 (10~12月)	2022年3月期 3Q実績累計 (4~12月)	業績予想比 (進捗率)
売上高	5,096	2,506	1,332	3,839	75.3%
営業利益	280	130	136	266	95.0%
経常利益	286	143	138	282	98.6%
当期純利益	200	85	94	179	89.5%

	2022年3月期 業績予想 (8/11修正)	2022年3月期 修正業績予想 (2/10修正)	増減額	増減率
売上高	5,096	5,300	204	4.0%
営業利益	280	348	68	24.3%
経常利益	286	365	79	27.6%
当期純利益	200	244	44	22.0%

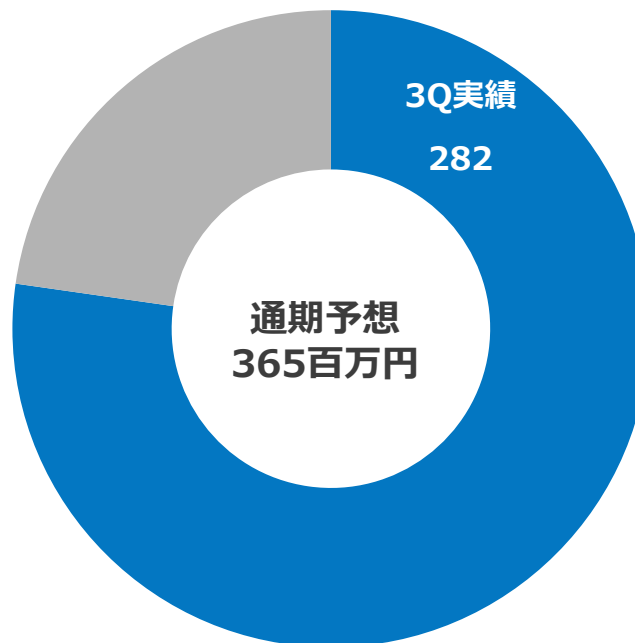
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

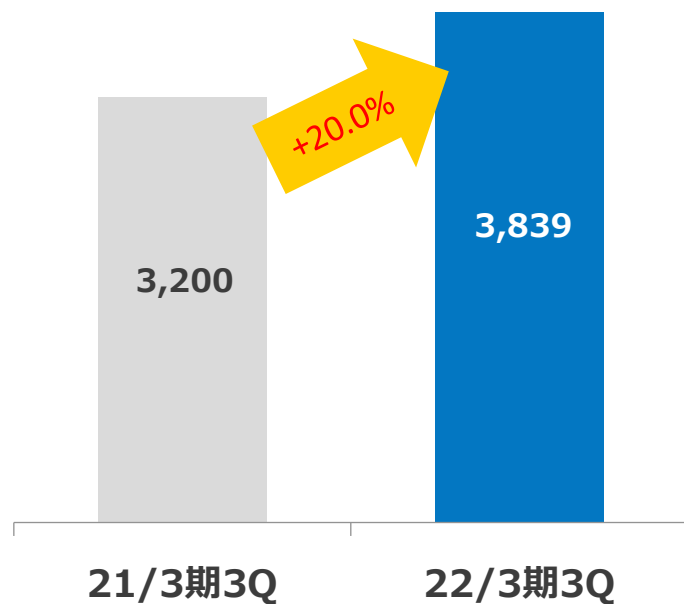
(単位：百万円)



※通期予想は、2/10上方修正後の数値。  
3Qまでの実績は順調に推移。

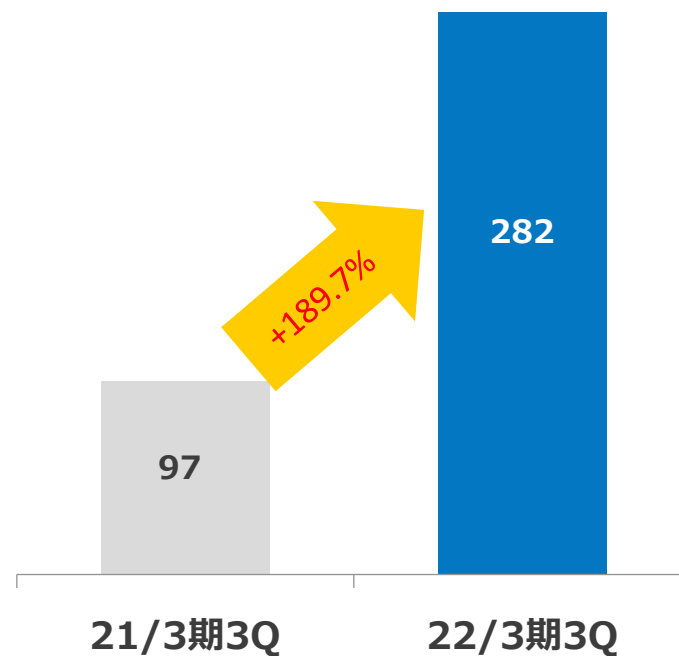
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

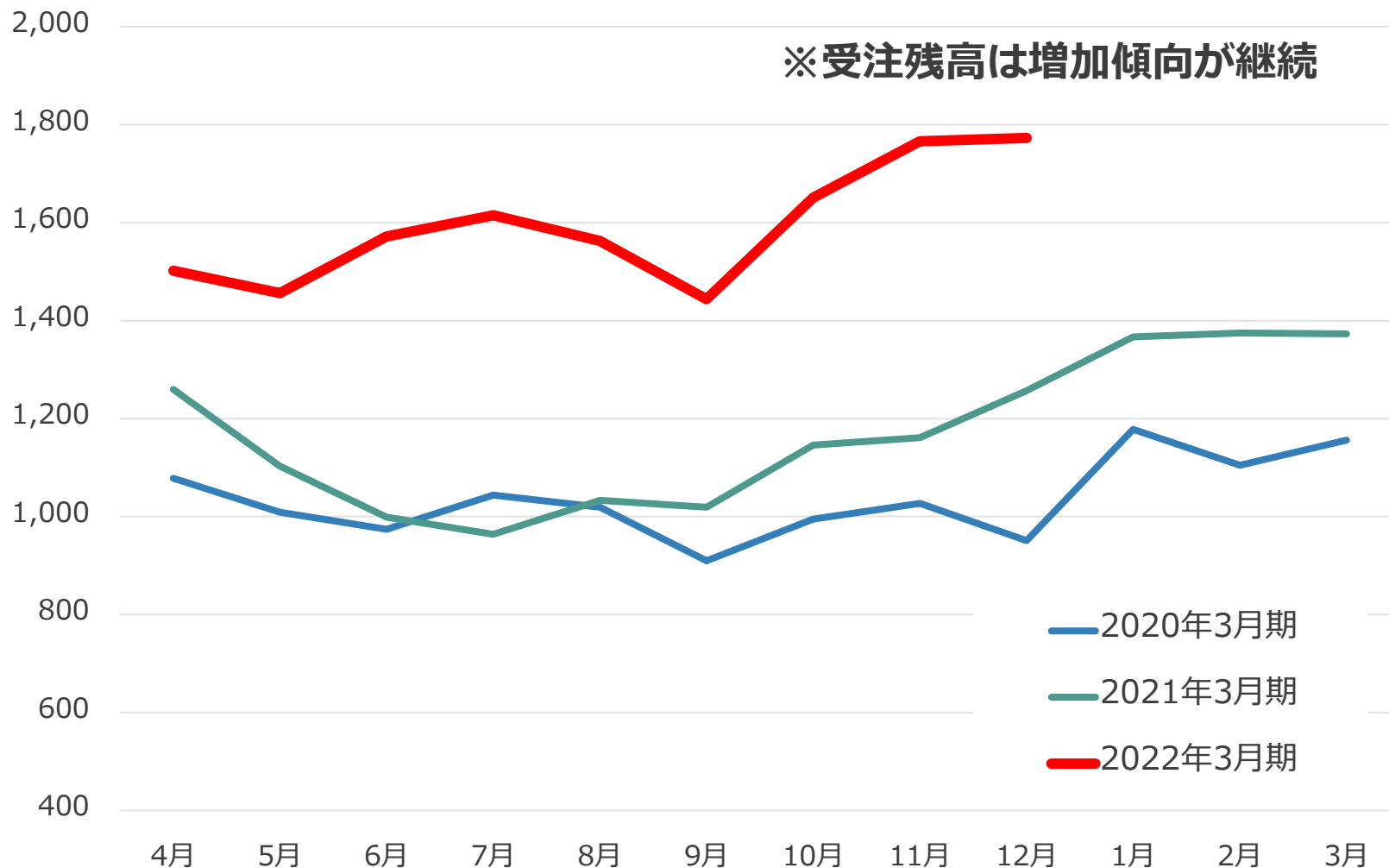
(単位：百万円)

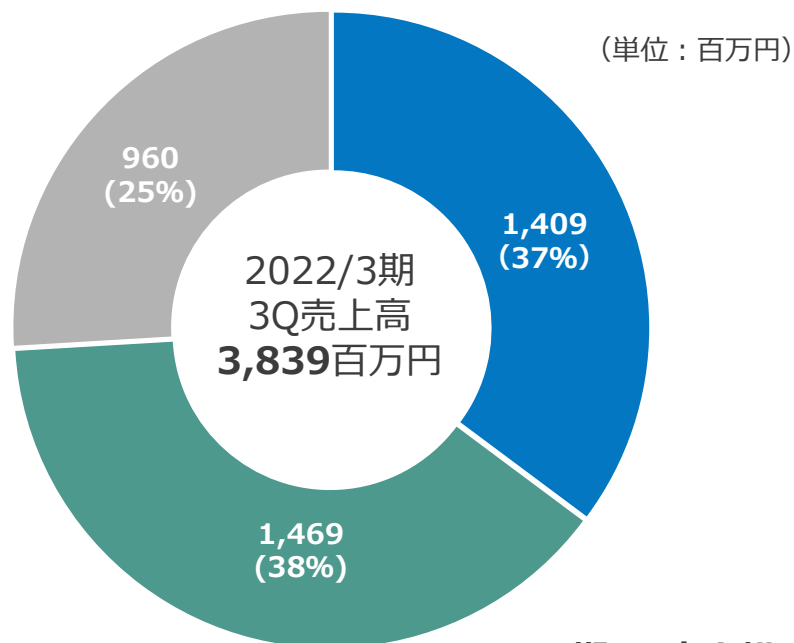


※売上高・経常利益とも前年同期比で増収増益で推移。

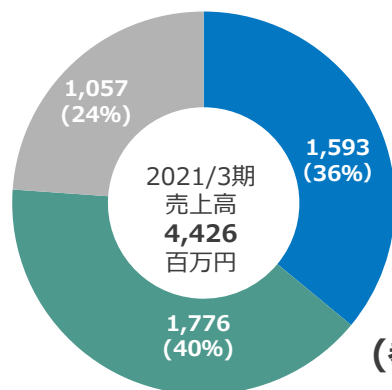
## 【受注残高（全社）】

(単位：百万円)





22/3期3Q売上構成



(参考) 21/3期売上構成

## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造  
IoT-PLC通信モジュール

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計（アナログ・デジタル）、IP開発

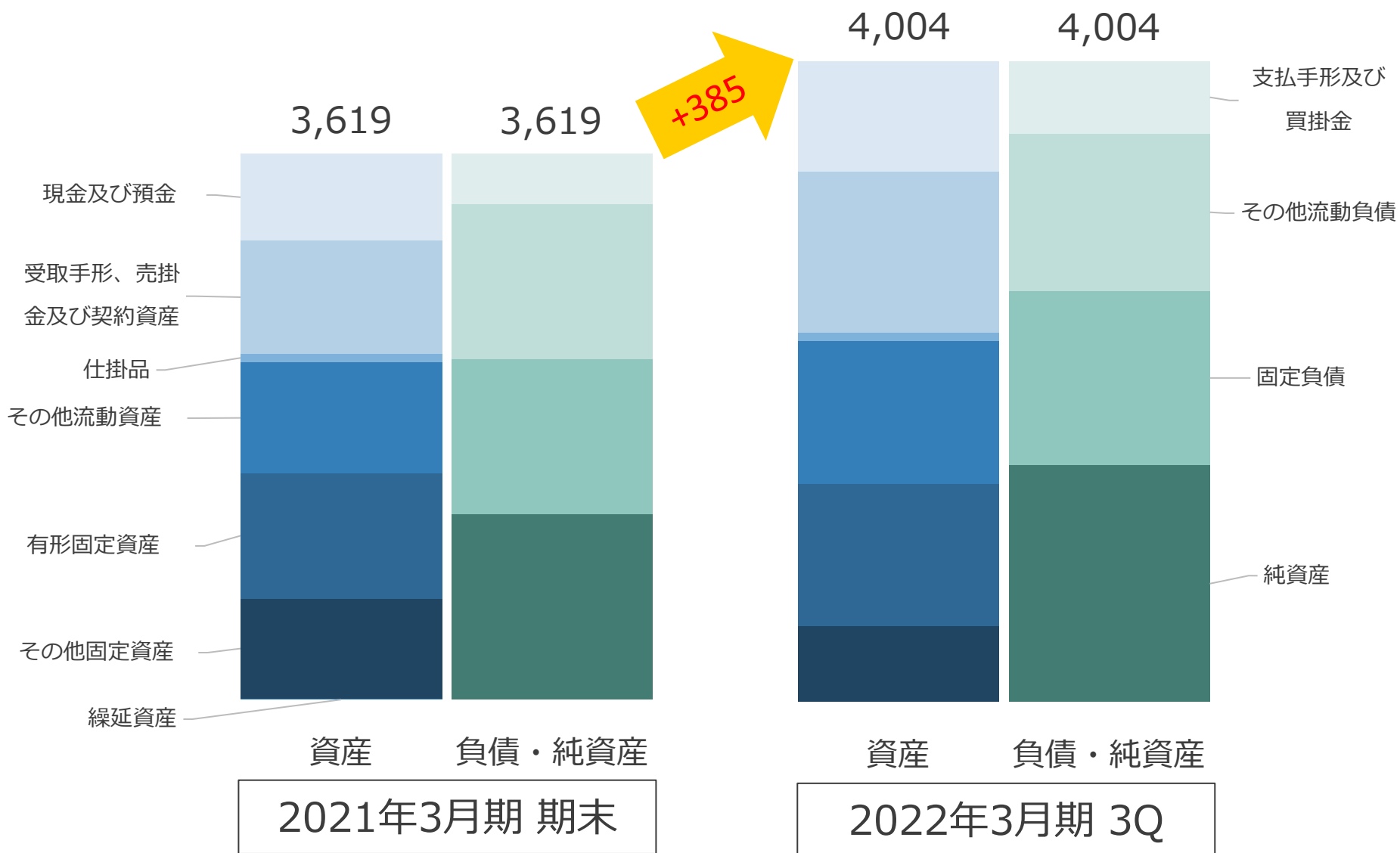
電源IC設計、高速I/F回路設計、イメージセンサ回路設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計  
JPEG、MIPI、IPコア

## 製品開発事業

### 画像関連機器開発

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

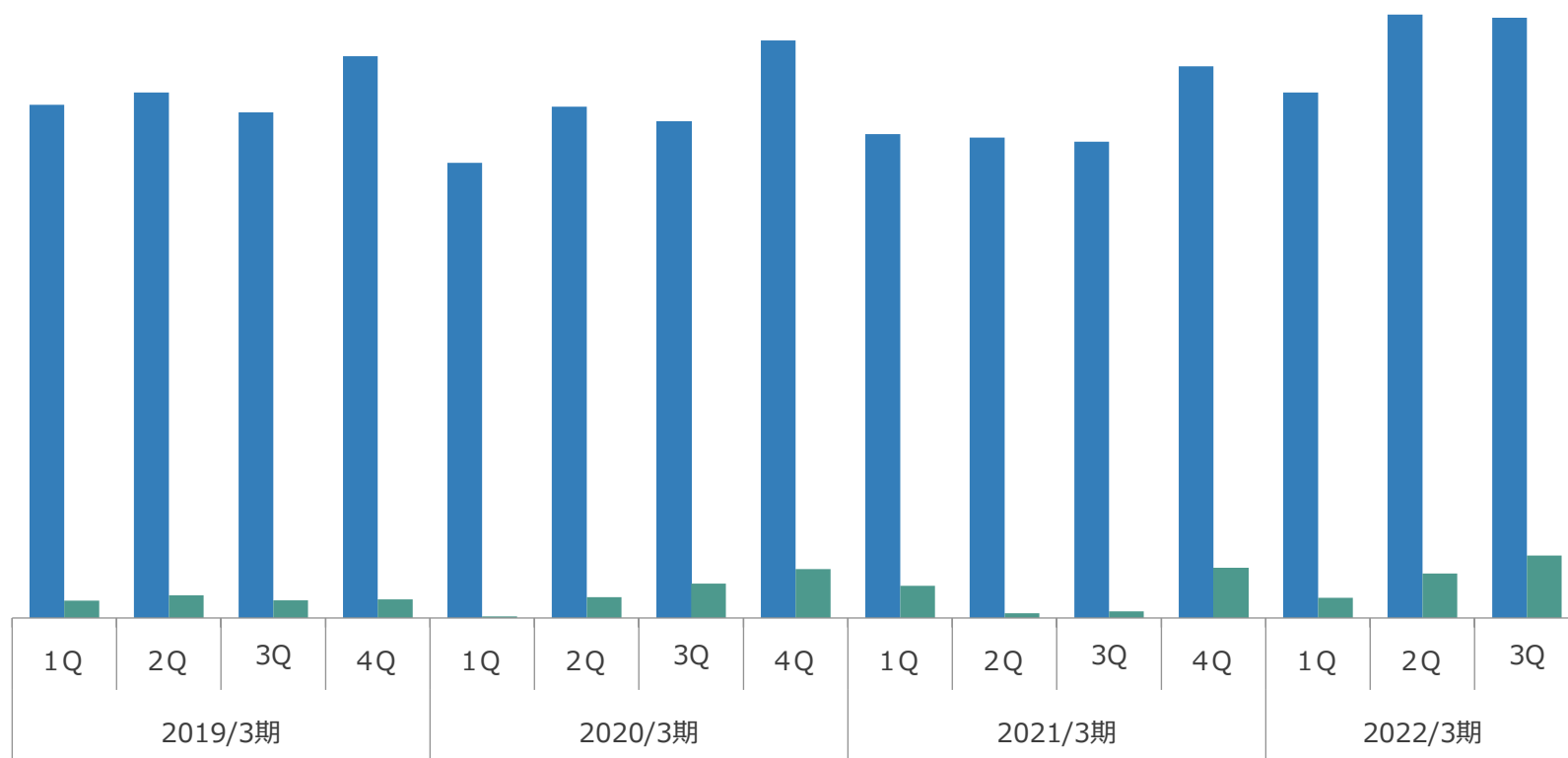
(単位：百万円)



<b>2021年</b>	4月21日	第三者割当増資	<b>1Q</b>
	5月14日	決算発表	
	6月11日	決算説明会	
	6月28日	第49期 定時株主総会	
	7月 9日	東京証券取引所より「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果」の適合通知を受領	<b>2Q</b>
	8月11日	第2四半期 決算発表 通期利益を上方修正	
	10月 4日	130 万画素 MIPI 出力カメラモジュールの販売開始	<b>3Q</b>
10月18日	東京証券取引所の新市場区分 「スタンダード市場」選択を開示		
12月 3日	HD-PLC 第 4 世代規格 IEEE1901-2020 に準拠した電力線通信モジュールを試作		
<b>2022年</b>	1月28日	小型月着陸実証機「SLIM」航法カメラ開発	<b>4Q</b>
	2月 1日	九州事業所を拡張・機能強化	
	2月10日	第3四半期 決算発表 通期予想を上方修正	



■ 売上高 ■ 経常利益

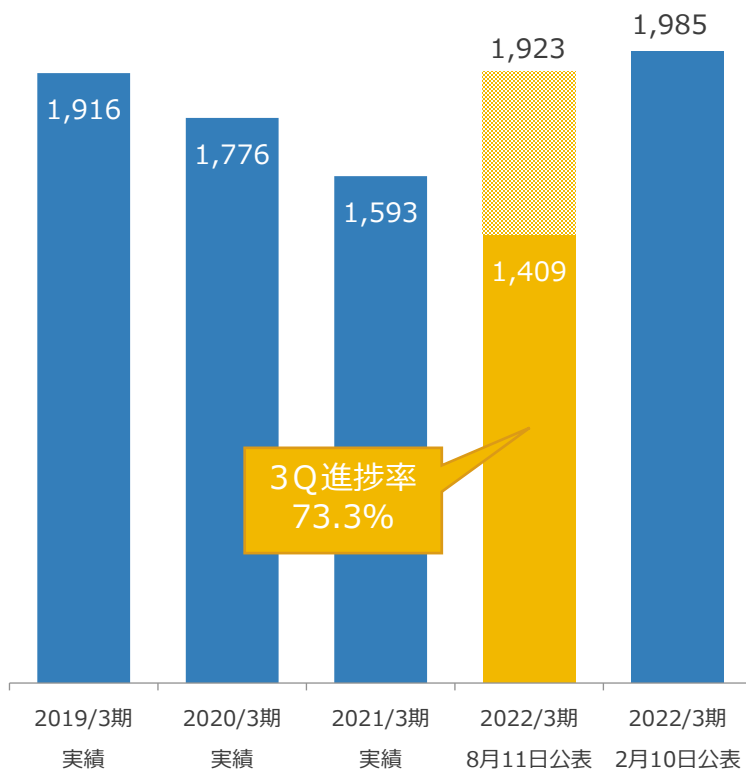


※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

車載向け半導体・車載向け機器市場の拡大により半導体後工程商材の受注拡大及び  
車載機器用専用計測機関連商材も対象製品の拡大と共に受注増加

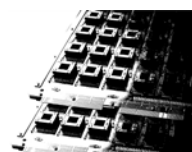
## 【売上高】

(単位：百万円)

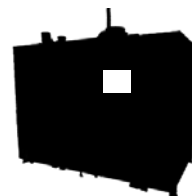


## 3Qトピックス

- 車載用半導体を中心に半導体検査商材の受注増



**バーンインボード**  
(車載・パワー・通信用等)  
前年同期比：157%



**半導体検査装置販売・リース**  
(カスタム装置含む)  
前年同期比：177%

- 車載製品向け計測機の受注増

**顧客別専用計測機関連**  
(機器の開発・製造)  
前年同期比：119%



- IoT-PLC通信モジュール

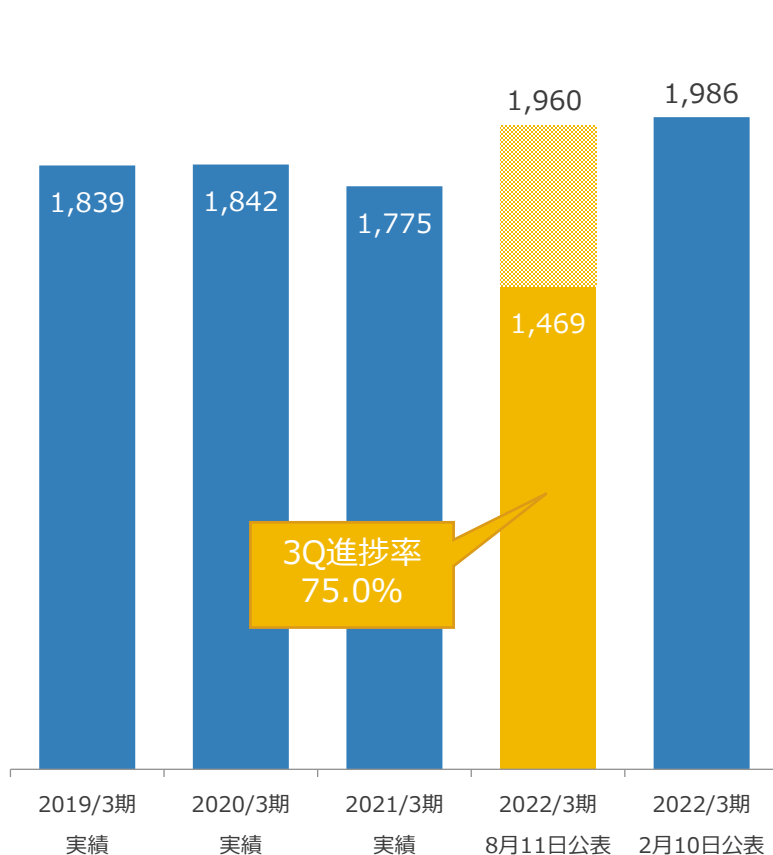
・スマートビルディング E X P O 初出展  
**HD-PLC** (HD-PLCアライアンス内ブース)



旺盛な半導体需要に支えられ、パワー半導体、センサー半導体、画像処理半導体の設計需要が堅調に推移、新たに開発した画像処理IPの組み込みも進展

## 【売上高】

(単位：百万円)



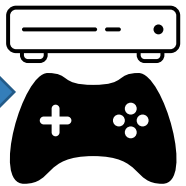
## 3Qトピックス

### ➤ アナログ半導体設計受託

EV向けセンサ関連  
アナログ設計受託  
前年同期比：168%



汎用商品向けパワー半導体関連  
アナログ設計受託  
新規受注

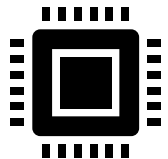


### ➤ デジタル半導体設計受託

DSC向け画像処理関連  
デジタル設計受託  
前年同期比：222%



画像処理IPの組み込み

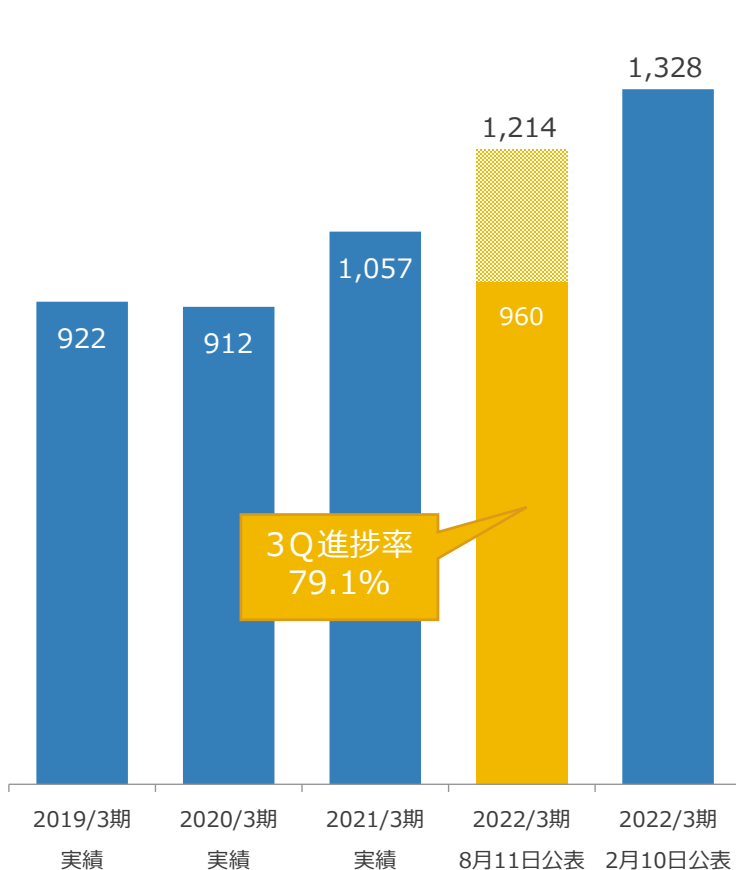


拡大するエッジAI市場に対応するためNVIDIA社等のAI向けボードコンピュータと直接接続が可能で且つ画像処理機能を内蔵した130万画素MIPIカメラを新たに製品化

## 3Qトピックス

### 【売上高】

(単位：百万円)



### ➤ エッジAI用カメラ新製品リリース

- ・製品名 : 130万画素MIPIカメラモジュール
- ・型番 : KBCR-S08MM
- ・サンプル : 2021年10月
- ・量産時期 : 2022年 1月



### 【特長】

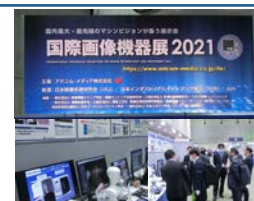
- ・市販ボードコンピュータと互換性のあるI/Fを採用
- ・AIシステムに最適なNVIDIA® Jetson Nano™ 専用のV4L2Linuxドライバを提供
  - ※NVIDIA® Jetson Nano™ は NVIDIA Corporationの登録商標です。
- ・標準対応レンズ 2種類により幅広いシーンで活用可能
- ・Image Signal Processor搭載 カメラ内部で自動画質調整

### ➤ 国際画像機器展2021出展

2021/12/1-12/3 パシフィコ横浜

画像センシング用「組込カメラモジュール」を新製品を中心に展

エッジ処理からクラウドまで先進の画像処理に対応



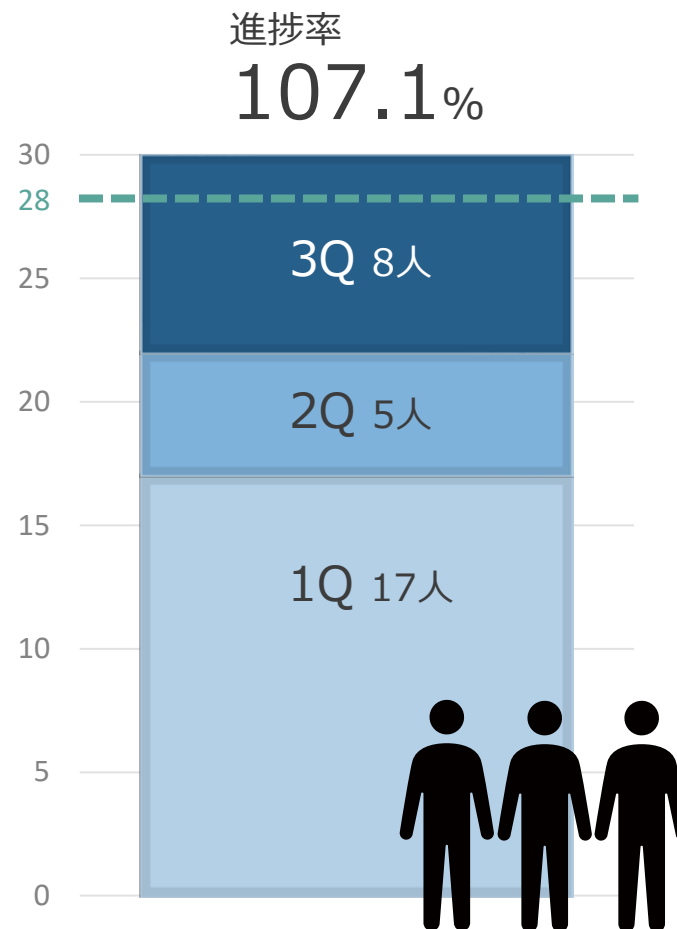
半導体事業における増産に対応するため、  
人員増強を図っております。

また、同期間中に退職者が発生したこと  
に伴い、採用枠を増加。

通期で28人の採用計画に対し、3Qまで  
30人の採用となりました。

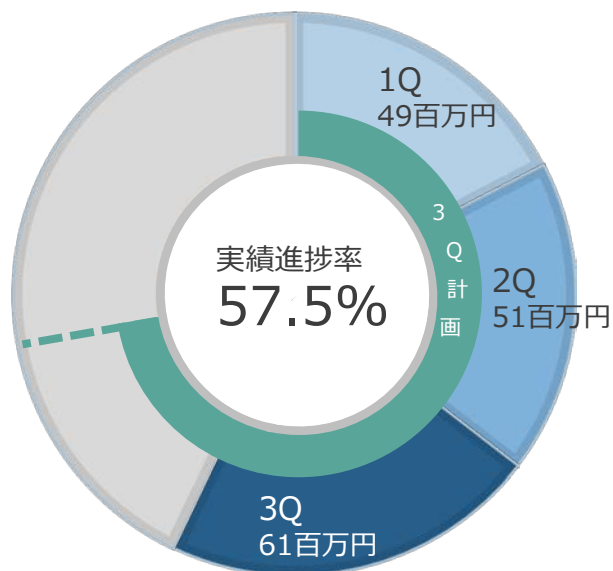
人員

通期採用計画：28人



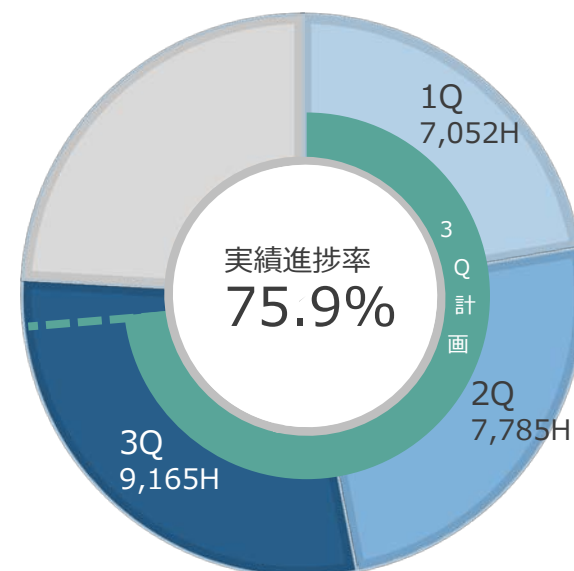
研究開発に投下している「工数」は順調に進捗しています。

研究開発費での進捗に対する差分は、主に開発単価の予実差異によるものとなります。



## 研究開発費

通期計画：282百万円  
 (うち、3Q計画：204百万円)



## 研究開発工数

通期計画：31,626H  
 (うち、3Q計画：23,178H)

顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して優位性のある技術・製品の開発に取り組みます。

## 研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、  
IPコア、高速IF回路、  
画像処理システム、カメラの性能向上、  
新機能開発

### 電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置  
IoT-PLC通信モジュール

### マイクロエレクトロニクス事業

- ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

### 製品開発事業

- ・エッジAIカメラ・高画素インテリジェントカメラ・介護向けシステム

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

## 【お問い合わせ先】

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>